



## 产品规格书/Specification

产品/product:	<b>导电银浆/ Silver paste</b>
料号/Part number:	<b>01L-3608B</b>

- ※ 150~200℃加热固化银浆
- ※ 最高耐温 300℃, 短时间内(2 小时)350℃
- ※ 用于芯片, 陶瓷, 玻璃, 金属等粘合
- ※ 点胶, 印刷均可

### 适用范围/Application:

单组分导体浆料系列, 一种附着力可靠的用来固定芯片的导电银浆。此浆料适合粘贴各类芯片到电路板、玻璃、陶瓷等基材, 射灯, 需要耐温150以上的柔性电路, 与基体的匹配性能良好, 不流挂, 用该浆料制出的电极固化后外觀光亮、细腻, 结构致密。

Single component conductor paste series, the paste is suitable for pasting various chips into the circuit board, glass, ceramic and other substrates, matching with the substrate is good.

基材 Substrate	电路, 玻璃, 陶瓷, 金属, 芯片, PI Thick film circuit, glass, ceramic, metal.	
使用方法 Method of use	点胶, 印刷, 涂抹 Dispensing ( by needle cylinder, etc.), Printing	
流平 Leveling	3-5min minutes at room temperature 室温下流平 3-5 分钟 (时间根据流平的实际情况决定)	
固化 Curing conditions	在恒温烘箱,或者持续热风 (以下条件选其一即可)	
	150℃	60 分钟/mins
	180℃	30 分钟/mins
	200℃	30 分钟/mins
250℃	20 分钟/mins	
Viscosity 粘度	120-220Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。
固体含量 content	65-80%	银 Silver, Glue
方阻 Resistivity	≤20mΩ/□	方阻测试法 (300℃20 分钟固化后) 固化膜厚 10μm, 测试图形 100mm*1mm Cured film thickness 10-25μm, test pattern 100mm * 1mm



深圳市赛雅电子浆料有限公司

Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

电话, 微信: 13510026516

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

	≤10mΩ/□	四针探测法 25.4u Four-needle probe 25.4u
附着力 Adhesion	无脱落 Not fall off	3M 600#胶带 90°拉 3M 600#Tape 90°Pull
差异性 Differences	01L-2608B	粘合型, 导电性较均衡, 满足大多数产品
	01L-2609S	更强的粘合力, 但相比 01L-2608B 电阻略大。

### 使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	电路, 玻璃, 陶瓷, 金属, 芯片, PI Thick film circuit, glass, ceramic, metal.
使用方法 Method of use	点胶, 印刷 Dispensing ( by needle cylinder, etc.), Printing
流平 Levelling	5-10min minutes at room temperature 室温下流平 5-10 分钟 (时间根据流平的实际情况决定)。
固化 Curing conditions	通风烘箱烘烤 150~200℃, 30 分钟 (固化温度可以在 150-200℃ 范围内, 固化时间可根据实际情况决定) 150-200℃, 30 min ( It could be cured at a temperature between 130 ~ 180℃, but it depends of the thickness and the substrate.)
稀释剂 Thinner	ST-1001

### 性能/Characteristics:

#### 1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤15μm	FOG test
2 Viscosity	80-280Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。
3 固体含量 Solid content	70	银 Silver

#### 2. 烧结后特性/Characteristics after curing:

在 1 烧结条件下, Check fired film produced under the conditions specified in 1),

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
4 Resistivity 方阻	≤30mΩ/□	



深圳市賽雅電子漿料有限公司  
Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

电话, 微信: 13510026516

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

5	硬度 Hardness	4H	铅笔硬度 Pencil hardness
6	剪切强度 Shear strength	12Mpa	

**保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity**

产品应在 5-15°C 的环境温度下密封储存, 有效期为产品发货之日起六个月。

The product shall be guaranteed for 6 months after shipping date, keep tightly under at 5-15°C

**包装方式/Packaging method:**

标准包装, 1000g/罐, 样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.